



# 제25회 한국반도체학술대회

The 25<sup>th</sup> Korean Conference on Semiconductors

2018년 2월 5일(월)-7일(수), 강원도 하이원리조트 컨벤션 호텔

2018년 2월 7일(수), 13:15-14:45

Room C (함백, 5층)

## I. MEMS & Sensors Systems 분과

### [WC3-I] Flexible Sensor Systems

|                        |   |
|------------------------|---|
| WC3-I-1<br>13:15-13:45 | <b>[초청]</b><br><b>Wafer-Level Fabrication of Biodegradable Silk Fibroin Using UV Lithography</b><br>Hyunjoo J. Lee<br><i>School of Electrical Engineering, KAIST</i>  |
| WC3-I-2<br>13:45-14:00 | <b>키리가미 구조 기반의 스트레처블 기판의 제작 방법</b><br>윤지성, 윤광석<br><i>서강대학교 전자공학과</i>  |
| WC3-I-3<br>14:00-14:15 | <b>압전 에너지 수확소자가 집적된 유연한 압저항 스트레인 센서 제작 방법</b><br>김기홍, 윤광석<br><i>서강대학교 전자공학과</i>   |
| WC3-I-4<br>14:15:14:30 | <b>Biocompatible Silk Adhesives for Roust Adhesion of Epidermal Sensors</b><br>Hyojung Kim, Ji-Won Seo, and Hyunjoo J. Lee<br><i>School of Electrical Engineering, KAIST</i>  |
| WC3-I-5<br>14:30-14:45 | <b>Flexible Bimodal Sensor with Ink-Jet Printing Technique</b><br>Minhyun Jung <sup>1</sup> , Kyungkwan Kim <sup>1</sup> , Taeho Kim <sup>1</sup> , Heedo Chae <sup>2</sup> , Haena Cheong <sup>2</sup> , Oh-sun Kwon, Kwanwoo Shin <sup>2</sup> , and Sanghun Jeon <sup>1</sup><br><i><sup>1</sup>Department of Applied Physics, Korea University, <sup>2</sup>Department of Chemistry and Institute of Biological Interfaces, Sogang University</i> |